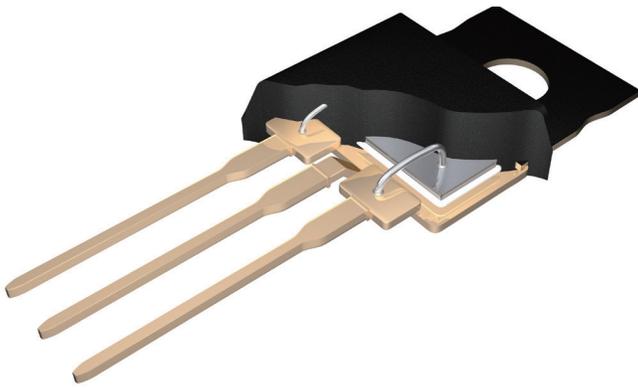


**LOCTITE®**

# 车规级无压烧结 超高导热芯片粘接胶

LOCTITE® ABLESTIK ABP 8068TI



LOCTITE® ABLESTIK ABP 8068TI  
超高导热结芯片粘接胶

LOCTITE® ABLESTIK ABP 8068TI 是一款高性能芯片粘接胶，适用于汽车和工业应用中具有高导热和电气性能的引线框架封装。与需要压力的传统银烧结材料不同，LOCTITE® ABLESTIK ABP 8068TI 具备标准的芯片粘合剂的加工能力和低温固化能力（175°C），可以在主体结构 and 界面上形成刚性烧结银网络。此外，该产品还具有 165 W/m-K 的优秀导热率，在温度循环后能够保持稳定的导通电阻。



Henkel Adhesive Technologies

### 技术信息

技术 无压烧结

颜色 银色液体

触变指数 (0.5/5 rpm) 6.5

Brookfield粘度  
CP51 25°C mPas (cP) 转速5 rpm:  
13,000

体积电阻率 (ohm-cm)  $9.00 \times 10^{-06}$

260°C时的芯片剪切强度: (kg-f):

7x7 mm银BSM芯片粘接在银基材上	60
2x2 mm银BSM芯片粘接在银基材上	12.3

热膨胀系数 (ppm/°C) 26

堆积导热率 (W/mK) 165

-65°C: 27.9

DMA拉伸模量 (GPa) 25°C: 24.0

150°C: 13.8

200°C: 9.4

最佳储存温度 -40°C

### 主要特性和优势:

#### 高可靠性

- 满足严苛的车规级可靠性标准
- 对尺寸<3.0mm×3.0mm的芯片具有高附着力, 在银/铜或PPF引线框架上无空洞
- 在银、铜、镍钯金和金等多种基材表面上具有高芯片剪切强度
- 卓越的导热和电气性能
- 堆积导热率高达165W/m-K
- 出色的导电性和封装内导通电阻性能, 1,000次热循环后导通电阻稳定

#### 低温烧结

- 芯片粘接的替代解决方案, 无需高压和高温即可实现烧结
- 对于银、金和PPF表面, 在175°C或以上温度下完全固化, 可在空气和氮气环境中固化
- 无压烧结工艺不会在薄芯片上产生应力/只会产生低应力

#### 可加工性/加工性能

- 标准芯片粘接胶的点胶工艺, 没有银沉积或分离
- 24小时稳定一致的点胶性能
- 3小时晾置时间, 无可见空洞
- 在空气中静置的24小时内, 具有一致的芯片剪切强度

#### 健康与安全性

- 与其他高导热芯片粘接胶相比, VOC含量少

## 您对具备市场领先的导热和电气性能的材料感兴趣吗?

欢迎联系汉高技术专家。

[henkel-adhesives.com/electronics](http://henkel-adhesives.com/electronics)

#### 汉高总部

Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstraße 67  
40589 Düsseldorf  
Germany

电话: (+49) 211 797-0

#### 亚太及大中华区总部

汉高(中国)投资有限公司  
中国上海市杨浦区江湾城路99号  
尚浦中心7号楼 200438  
中国

电话: (+86) 21 2891 800

#### 北美地区

Henkel Corporation  
14000 Jamboree Rd  
Irvine, CA 92606  
United States

电话: (+1) 248 583 9300